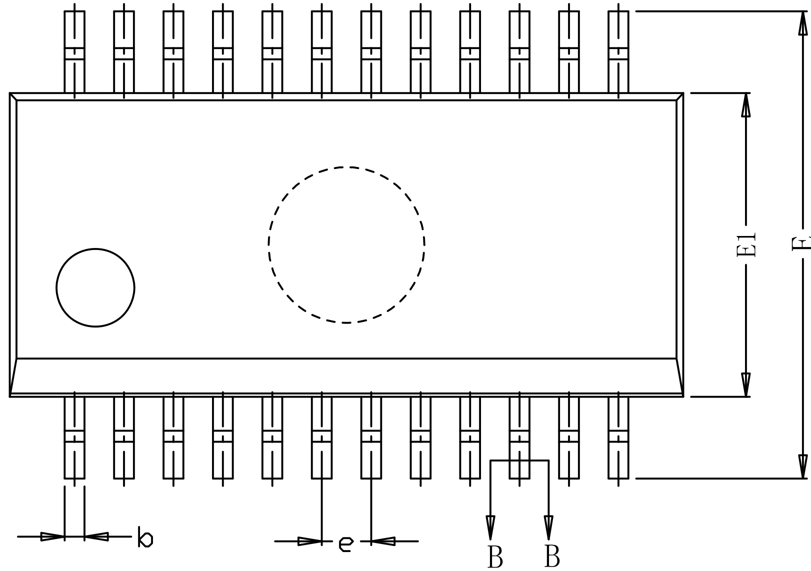
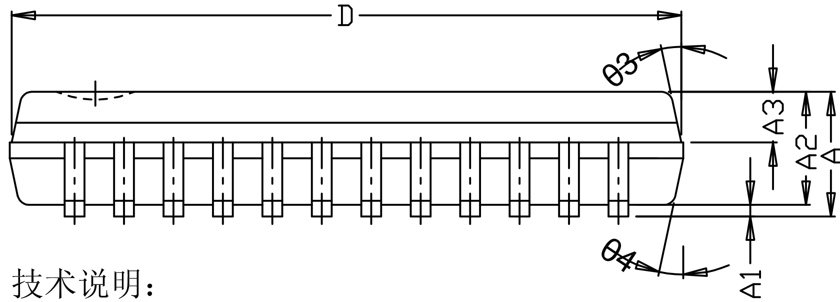
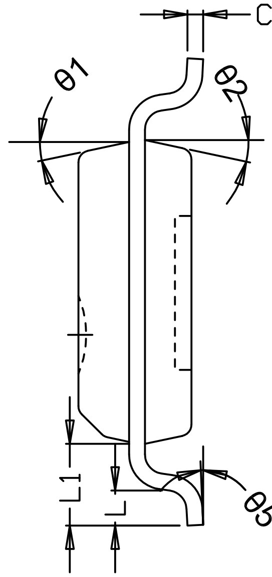
四川明泰电子科技有限公司
Si Chuan Mountek Electronic Technology Co., Ltd.

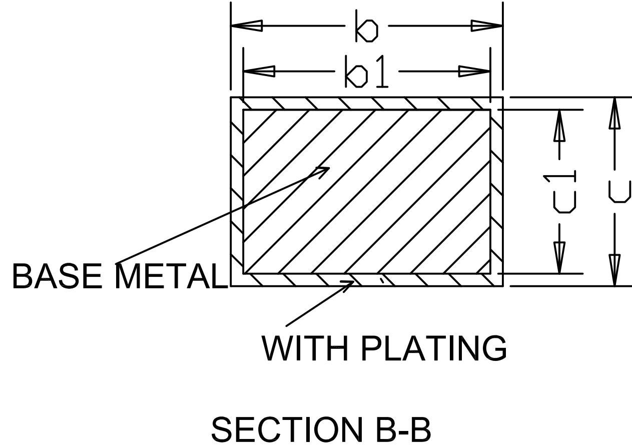
MARK	MARK	REVISION RECORD	REVISERE	APPROVER
1				
2				

QSOP24 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS









SECTION B-B

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	--	--	1.7
A1	0.10	0.15	0.21
A2	1.40	1.45	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.20	--	0.29
b1	0.20	0.24	0.27
c	0.18	--	0.23
c1	0.16	0.19	0.21
D	8.45	8.60	8.75
E	5.8	6.00	6.20
E1	3.75	3.85	3.90
e	0.635(BSC)		
L	0.58	0.60	0.63
L1	1.05(REF)		
θ1	8°	~	15°
θ2	8°	~	15°
θ3	8°	~	15°
θ4	8°	~	15°
θ5	0°	~	6°

技术说明：

1）LEADFRAME MATERIAL：COPPER；
引线框架材料：铜；

2）LEADFRAME THICKNESS：0.203mm；
引线框架厚度：0.165mm；

3）BOTH PACKAGE LENGTH AND WIDTH DO NOT INCLUDE MOLD FLASH；
塑封体长度及宽度尺寸不包括塑封溢胶；

4）REFERENCE：JEDEC MS-013,MS-012。
参考标准：JEDEC MS-013,MS-012。